

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 4 年 1 月 4 日 (2022.1.4)

【公開番号】特開 2021-90078 (P2021-90078A)

【公開日】令和 3 年 6 月 10 日 (2021.6.10)

【年通号数】公開・登録公報 2021-026

【出願番号】特願 2021-38489 (P2021-38489)

【国際特許分類】

H 0 1 S 5/022 (2021.01)

【F I】

H 0 1 S 5/022

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 11 月 16 日 (2021.11.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 6】

本発明の光半導体素子収納用パッケージは、第 1 上面と、前記第 1 上面に光半導体素子が載置される載置部とを有する基板と、前記基板の前記第 1 上面に位置した枠体と、第 2 上面と、断面視において前記第 2 上面と連続して前記基板と間を空けて対向して位置した第 1 側面と、前記第 1 側面と対向して位置した第 2 側面とを有する支持部と、前記基板の前記第 1 上面から前記支持部の前記第 2 上面にかけて位置するとともに、前記枠体と接合され、平面透視において前記基板から張り出した第 3 側面を有する入出力端子と、を備えており、側面視または断面視において、前記第 3 側面は、前記第 2 側面よりも外方に位置している。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 上面と、前記第 1 上面に光半導体素子が載置される載置部とを有する基板と、前記基板の前記第 1 上面に位置した枠体と、第 2 上面と、断面視において前記第 2 上面と連続して前記基板と間を空けて対向して位置した第 1 側面と、前記第 1 側面と対向して位置した第 2 側面とを有する支持部と、前記基板の前記第 1 上面から前記支持部の前記第 2 上面にかけて位置するとともに、前記枠体と接合され、平面透視において前記基板から張り出した第 3 側面を有する入出力端子と、を備えており、側面視または断面視において、前記第 3 側面は、前記第 2 側面よりも外方に位置した、光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項 2】

平面視において、前記支持部は、前記入出力端子の前記第 3 側面が位置する外縁に沿って位置している、請求項 1 に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項 3】

下面視において、前記入出力端子は前記基板から張り出した第 1 角部を有しており、

前記第 1 角部は、円弧状である、請求項 1 または 2 に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項 4】

下面視において、前記支持部は、前記第 1 角部よりも内方に収まっている、請求項 3 に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項 5】

平面視において、前記支持部は矩形状であり、  
平面視において、前記支持部の第 2 角部は、R 面または円弧状である、請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項 6】

平面視において、前記入出力端子は、第 1 絶縁層と、前記第 1 絶縁層の上面のうち外方に張り出した箇所が上方に露出するように前記第 1 絶縁層の上面に位置した第 2 絶縁層と、前記第 2 絶縁層の上面のうち外方に張り出した箇所が上方に露出するように前記第 2 絶縁層の上面に位置した第 3 絶縁層とを含んでいる、請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項 7】

断面視または側面視において、前記基板の側面は、前記第 3 絶縁層の外方に位置した側面よりも内方に位置した、請求項 6 に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項 8】

断面視または側面視において、前記支持部は前記第 1 絶縁層および前記第 2 絶縁層の両方と重なっている、請求項 6 または 7 に記載の光半導体素子収納用パッケージ。

【請求項 9】

請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項に記載の光半導体素子収納用パッケージと、前記基板の前記載置部に載置される光半導体素子と、前記枠体に接合される蓋体とを備える光半導体装置。